

証券コード 3436

SUMCO 株主通信

第18期 中間期

2016年1月1日～2016年6月30日

● INDEX

- 01 ごあいさつ／連結業績ハイライト
- 03 2016年上期(1-6月期)の事業成績
と3Q累計(1-9月期)の業績見通し
- 04 決算Q&A
- 05 特集：300mmシリコンウェーハの
市場動向
- 07 連結財務諸表
- 09 会社情報
- 10 株式情報・株主メモ



SUMCO

未来を創造する技術を育てています

ごあいさつ

株主の皆様には日ごろから格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

私たちの生活は、電子携帯端末とインターネットの普及により、飛躍的に変わってきております。

昨今、産業機械や自動車など、さまざまなモノがインターネットに繋がるIoT (Internet of Things) やSNS (Social Networking Service) の利用が拡大し、音声や写真、動画など大量のデジタルデータが瞬時に配信され、保存される潮流が続いております。

半導体向けシリコンウェーハ市場は、上記デジタルデータ向けや昨年の在庫調整が終了したスマートフォン向けとともに堅調に推移しました。

ハイエンドのスマートフォンは益々高機能化・高性能化が進んでおります。ミドルレンジのスマートフォンの上位機種は、高級機種と遜色の無い性能を有し、ミッド・ハイという新たなカテゴリーが出現し、300mmエピタキシャルウェーハの需要を牽引しています。

300mmポリッシュト・ウェーハは、デジタルデータを保存し処理するSSD (Solid State Drive) 用のNANDメモリーやDRAM向けに、強い需要が続く見込みです。

また、自動ブレーキなどに代表される車載向け半導体需要やIoT向けが著しく成長していることにより、200mm以下の小口径ウェーハも需要が回復はじめております。

このような環境のもと、当第3四半期の半導体用シリコンウェーハ市場は、強い回復基調が継続すると予想しておりますが、輸出比率が高い当社グループは足許の更なる円高が、業績に影響を与える懸念がございます。

当社グループでは、「SUMCOビジョン」の方針に基づき、最先端技術開発の推進による製品の差別化を図り、顧客でのプレゼンスを高めるとともに、コスト低減による損益分岐点の改善に努めてまいります。

2016年12月期の中間期の配当につきましては、当期における利益水準、将来の見通し、設備投資に係る資金需要および内部留保の状況等を総合的に勘案し、1株当たり5円と決定いたしましたのでご報告します。尚、期末配当につきましては、未定とさせていただきます。

今後とも倍旧のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸



株主の皆様には平素より当社へのご理解とご支援を戴き厚く御礼申し上げます。

当上期の業績は、年初来の円高の進行と熊本地震の影響による販売生産量の減少により前年同期比では厳しいものとなりました。

今後の業績につきましては、足許の円高継続による業績懸念がございますが、300mmウェーハの需要は増加しつつあり、また、200mmウェーハも堅調な需要が続いております。

今後も更なる体質強化に向けた先端技術開発や高精度化投資により技術力を強化し、高付加価値品需要を確実に取り込むことで収益基盤を一層確実なものとしてまいります。

また、歩留、原単位低減、生産性向上等のコストダウンを推進し、コスト競争力を高め、一層の利益をあげるよう努力してまいります。

確実に実力を高めていくことで、各指標を改善し、昨年の公募増資で強化されました体質をさらに強化し、中期目標としております、自己資本比率50%、グロスD/Eレシオ0.5、の財務体質の達成を目指してまいります。

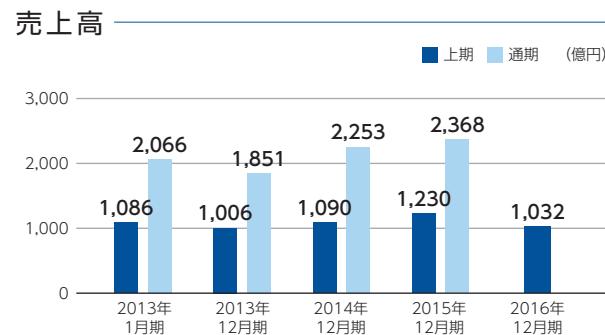
株主の皆様には、今後も引き続きご支援を賜りたくお願い申し上げます。

代表取締役 社長兼COO 瀧井 道治

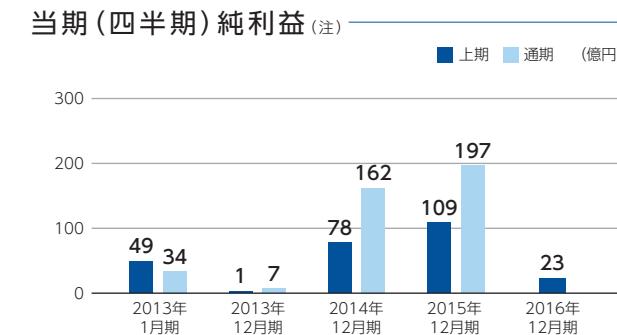
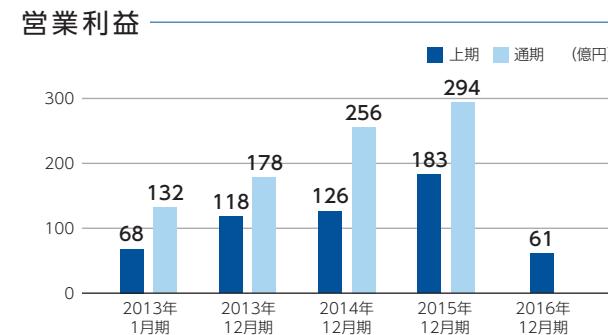
SUMCO VISION

1. 技術で世界一の会社
2. 景気下降局面でも赤字にならない会社
3. 社員が生き活きとした利益マインドの高い会社
4. 海外市場に強い会社

連結業績 ハイライト



(注) 日本会計基準。グラフ中の数字は億円未満切り捨て。



(注) 親会社株主に帰属する純利益

2016年上期(1-6月期)の事業成績と3Q累計(1-9月期)の業績見通し

市場環境と事業成績、および、3Q見通し

16年上期
(1-6月)
市場環境

当上期の半導体用シリコンウェーハ市場は、昨年後半からのスマートフォンの在庫調整が終了し、当社主力製品のロジック向け300mmエピタキシャル・ウェーハは、回復基調となりました。また、メモリー向けポリッシュト・ウェーハは、データセンター向けの需要拡大とスマートフォンのメモリー搭載容量増加により堅調に推移しました。

200mm以下の小口径ウェーハは、車載向け需要の拡大に加え、民生・産業向けが徐々に回復しました。

16年上期
(1-6月)
事業成績

このような環境のもと、当社グループでは、「SUMCOビジョン」の方針に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により、顧客でのプレゼンスを高めるとともに、コスト低減による損益分岐点の改善に努めてまいりました。

一方、年初来の急激な円高の進行は、当社グループの業績に大きな影響を与えました。

この結果、当上期における当社グループの業績は、売上高 1,032億円、営業利益 61億円、経常利益 43億円、親会社株主に帰属する四半期純利益23億円となりました。

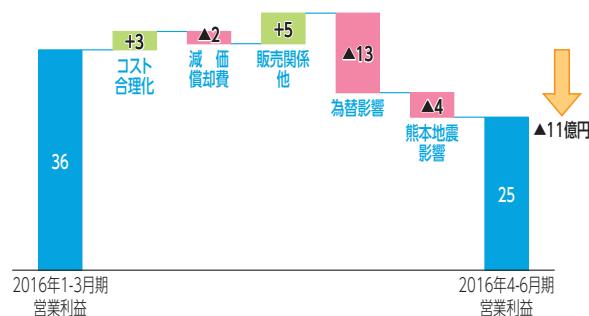
今後の
見通し

7-9月期の半導体用シリコンウェーハ市場は、回復基調が継続すると予想しております。しかしながら、輸出比率が高い当社グループは、足許の更なる円高により業績に大きな影響を受ける懸念があります。

2016年度3Q累計の連結業績については、3Q(7-9月)の為替レートを105円/ドルの想定で予想しております。

営業利益増減分析 (2016年1-3月期→2016年4-6月期)

単位:億円



2016年度3Q累計(1-9月) 連結業績予想

項目	2015年 3Q累計実績 (1-9月)	2016年 3Q累計予想 (1-9月)	増減額
売上高 (億円)	1,819	1,542	▲277
営業利益 (億円)	255	81	▲174
経常利益 (億円)	222	53	▲169
親会社株主に帰属する四半期純利益 (億円)	157	28	▲129
1株当たり四半期純利益 (円)	56.56	9.55	▲47.01
為替レート (円/\$)	120.9	111.5(*)	▲9.4

(*)1Q:118.3,2Q:111.1,3Q:105.0

注)業績予想等の将来に対する記述は、当社が現在入手している情報、および、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

決算Q&A

2016年8月5日に開催しました決算説明会における主な質疑応答をご報告します。

Q 配当の考え方について
教えて欲しい

A 配当に関しては、基本的には当年度の利益水準と将来の利益見通し、および、設備投資などの資金需要や内部留保の状況を総合的に勘案した上で、純利益の3割を目途に実施していく方針でございます。

当中間期の配当は、配当の継続性・配当利率などを考慮し、1株当たり5円に決定いたしました。

Q スマートフォンなどの最終製品の
需要見通しと300mmウェーハの
需要動向について教えて欲しい

A スマートフォンは、今年は年間15億台前後の出荷が予想されています。

台数増に加え、高級機種とのさらなる高機能化や、需要の多い中価格帯機種の一部が高級機種並みの性能になっており、引き続き300mmウェーハ需要を牽引すると予想しています。

一方、PCは、販売台数の減少はあるものの、ハード・ディスク・ドライブ(HDD)からNANDメモリーを使用したソリッド・ステート・ドライブ(SSD)への置き換えが進展しており、1台当たりのメモリー搭載容量は増加しています。

以上に加え、大量のデジタルデータを保存するデータセンター向けのメモリー需要が急成長しています。この分野も300mmウェーハ需要を牽引し、増加が続くと予想しています。

Q 200mmウェーハの市場動向について
教えて欲しい

A 200mmウェーハは、2006年に需要がピークを迎え、その後、新製品の300mmへの置換・進展により、需要は減少傾向に転じました。

しかしながら、昨今、自動ブレーキなどに代表される自動車向け需要の飛躍的な増加や、エアコンの省電力インバータ制御、モータの回転数制御、スマートフォンなどの携帯情報端末の電源管理などに加え、ウェアラブル端末など、さまざまなモノがインターネットに繋がるIoT向けに裾野が急成長しており、需要は緩やかに回復基調に転じ始めています。

300mmシリコン ウェーハの市場動向

当社の主力製品である300mmシリコンウェーハの需要を牽引するスマートフォンのトレンドと300mmウェーハの世界需要動向についてご紹介します。

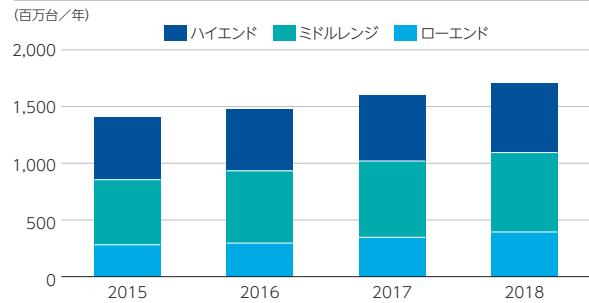
スマートフォンの世界出荷台数は今後とも拡大し、2018年には17億台を超えると予想されています。

機能・価格帯別の構成は、概ねハイエンド品が約1/3強、ミドルレンジ品が約4割強、残りの約2割強がローエンド品となっています。

スマートフォンに搭載される半導体のトレンドを見ると、ハイエンド品は益々高機能化し、メモリーの搭載容量は増え、3次元画像撮影用にデュアル・カメラを搭載する機種まで登場しています。ミドルレンジ品は、ハイエンド品に劣らない機能のものが徐々に増えつつあります。また、低価格のローエンド品も、メモリーなどの搭載容量は増える傾向にあります。

このような状況の中、スマートフォン1台当たりの300mmウェーハ消費量は、NAND向けを中心に増え続けていきます。

スマートフォンの世界出荷台数予想



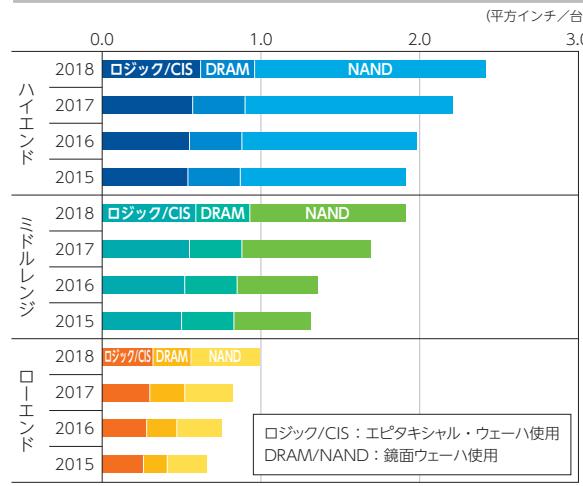
【出典:各種資料よりSUMCO推定】

スマートフォン用半導体のトレンド



【出典:各種資料よりSUMCO推定】

スマートフォン1台当たりの300mmウェーハ消費量



【出典:各種資料よりSUMCO推定】

今年の300mmウェーハの世界需要(EW+PW/TW)は、世界生産能力(SUMCO推定)とほぼ拮抗する状況です。来年以降は、世界生産能力を超える需要が見込まれ、サプライヤーが持つ在庫を出荷しても、需給が逼迫すると予想されます。

300mmウェーハ需要(用途別)を見ると、NAND向けとロジック向けが需要を牽引していることが判ります。

NANDは、スマートフォン、PC、タブレット向け需要のほかに、ビッグデータやクラウドなどのデータセンター向けが急成長しています。

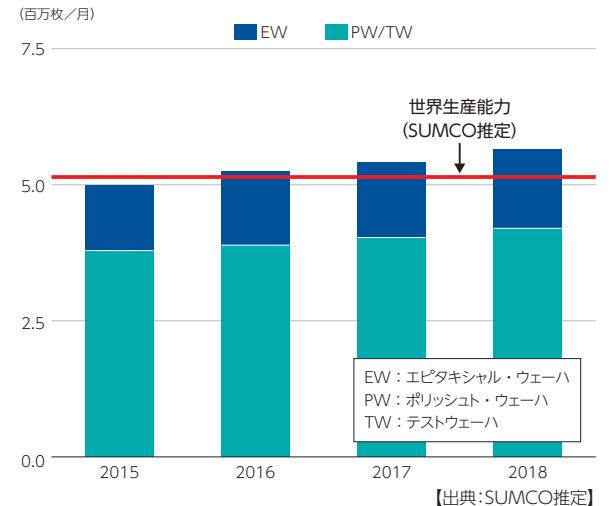
近年、スマートフォンに加え、さまざまな産業機械や自動車インターネットに繋がるIoT(Internet of Things)の時代を迎えようとしています。

NANDは、膨大に増加する各種情報や画像・動画などのデジタルデータを保存するのに適したメモリーのため、需要が急増しています。

ロジックは、膨大なデータを処理し、さまざまな演算をするために益々高機能化しており、各種情報端末の増加とともに増え続けています。

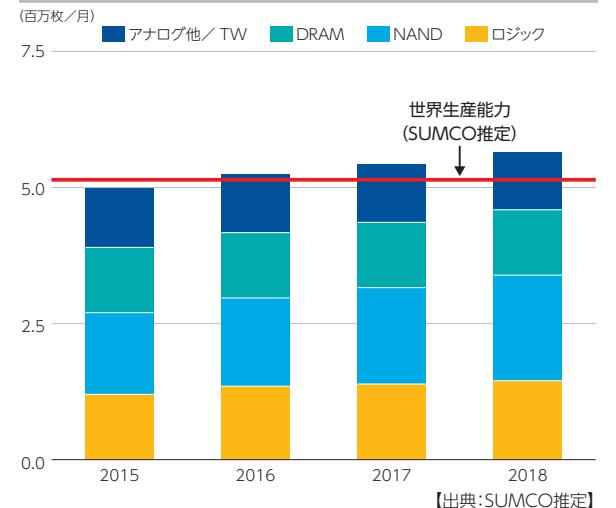
一方、今後数年間の半導体メーカーによる300mm設備増強投資計画によれば、ロジック/CIS(撮像素子)やNAND向けの設備増強が計画されており、300mmウェーハの需要は今後とも増加することが示唆されています。

300mmウェーハ需要予測(ウェーハ種別)



【出典:SUMCO推定】

300mmウェーハ需要予測(用途別)



【出典:SUMCO推定】

連結財務諸表

単位:百万円

連結損益計算書(要約)	前上期	当上期
	2015年1月1日~2015年6月30日	2016年1月1日~2016年6月30日
売上高	123,074	103,215
売上原価	92,082	84,938
売上総利益	30,991	18,277
販売費及び一般管理費	12,641	12,084
営業利益	18,350	6,193
営業外収益	248	485
営業外費用	3,259	2,372
経常利益	15,339	4,306
法人税等	2,357	813
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,068	1,185
親会社株主に帰属する四半期純利益	10,913	2,307
設備投資額	5,792	10,821
減価償却費	10,465	10,284
EBITDA	29,636	17,282

当上期の連結損益計算書のポイント (文中金額は億円未満切捨て表記)

売上高
昨年後半からの需要調整が終わり回復基調となりましたが、前年同期比では販売数量は減少しました。また、年初来の円高進行によるドル円の換算差や手取り金額の減少もあり、その結果、売上高は前年同期比198億円減の1,032億円になりました。

営業利益
コスト削減は進めたものの、円高や販売数量の減少などによる売上高の減少にともない営業利益は前年同期比121億円減の61億円になりました。

経常利益
営業外収益の4億円を加え、支払利息や為替差損などを含む営業外費用23億円を差し引いた結果、経常利益は前年同期比110億円減の43億円になりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益
法人税等8億円、非支配株主に帰属する四半期純利益11億円を差し引いた結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比86億円減の23億円になりました。

設備投資 他
最先端の半導体向け300mm高精度ウェーハを中心とした設備投資金額(検収ベース)は108億円、減価償却費は102億円で、EBITDAは172億円でした。

※EBITDA:営業利益+営業内減価償却費+のれん償却額で計算され、利益水準を示す指標の一つ

単位:百万円

連結貸借対照表(要約)	前期末	当期末
	2015年12月31日	2016年6月30日
(資産の部)		
流動資産	258,818	253,796
固定資産	231,024	221,542
資産合計	489,842	475,339
(負債の部)		
流動負債	111,550	103,636
固定負債	133,751	140,489
負債合計	245,301	244,125
(純資産の部)		
株主資本	210,594	209,969
その他の包括利益累計額合計	1,088	△7,024
非支配株主持分	32,857	28,269
純資産合計	244,540	231,213
負債純資産合計	489,842	475,339
自己資本比率	43.2%	42.7%
グロスD/Eレシオ	0.9	0.9

単位:百万円

連結キャッシュ・フロー計算書(要約)	前上期	当上期
	2015年1月1日~2015年6月30日	2016年1月1日~2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,305	13,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,843	△11,416
フリー・キャッシュ・フロー	9,461	2,414
財務活動によるキャッシュ・フロー	△24,545	△3,413
現金及び現金同等物の増減額	△14,274	△4,936
現金及び現金同等物の期末残高	51,442	40,873

当上期の連結貸借対照表、および、連結キャッシュ・フロー計算書のポイント (文中金額は億円未満切捨て表記)

資産合計
現預金等の減少などによる流動資産の50億円減少、償却進行などによる固定資産の94億円減少により、資産合計は前期末比145億円減の4,753億円になりました。

負債合計
有利子負債(長短借入金+リース債務)の減少などにより、負債合計は前期末比11億円減の2,441億円になりました。

純資産合計
親会社株主に帰属する四半期純利益の計上と配当金支払による株主資本の6億円減少、為替換算調整などによるその他の包括利益累計額合計の81億円減少、非支配株主持分の45億円減少などにより、純資産合計は前期末比133億円減の2,312億円になりました。

※自己資本比率:総資産に対する自己資本の割合
※グロスD/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合

自己資本比率、グロスD/Eレシオ
自己資本は前期末比87億円減の2,029億円となり、自己資本比率は42.7%、グロスD/Eレシオは0.9倍になりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益の減少などにより、前年同期比14億円減の138億円になりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
最先端の半導体向け300mm高精度ウェーハの設備取得などにより、支出は、前年同期比55億円支出増の△114億円になりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払などにより△34億円となりました。長期借入金の返済による支出の減少などにより、前年同期比では211億円支出が減少しました。

会社情報 (2016年6月末現在)

会社概要		
商号	株式会社SUMCO	
本社	〒105-8634 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 Tel : 03-5444-0808 http://www.sumcosi.com/	
設立年月日	1999年7月30日	
資本金	138,718百万円	
従業員数	連結 7,491名 単体 3,514名	
IRお問い合わせ先	広報・IR室 : 03-5444-3915	
取締役		
代表取締役 会長兼CEO	橋本 眞 幸	
代表取締役 社長兼COO	瀧井 道 治	
代表取締役 副社長	遠藤 晴 充	
取締役	専務執行役員	降屋 久
	専務執行役員	平本 一 男
	常務執行役員	井上 文 夫
	目代 史 朗	
	前川 晋	
取締役 (監査等委員)	吉川 博	
	片濱 久	
	田中 等 *	
	三富 正 博 *	
	太田 信一郎 *	
	中西 孝 平 *	

* 社外取締役 (独立役員)

事業所		
本社	東京	
営業拠点	東京、大阪、福岡	
製造拠点	九州事業所 伊万里工場 (佐賀県伊万里市)	
	九州事業所 佐賀工場 (佐賀県杵島郡江北町)	
	米沢工場 (山形県米沢市)	
	千歳工場 (北海道千歳市)	
	JSQ事業部 (秋田県秋田市)	
連結子会社		
国内	SUMCO TECHXIV株式会社 (長崎、宮崎)	
	SUMCOテクノロジー株式会社 (千葉)	
	SUMCOサービス株式会社 (佐賀)	
	SUMTECサービス株式会社 (長崎)	
	SUMCO保険サービス株式会社 (長崎)	
	日本台塑勝高株式会社 (佐賀)	
	海外	SUMCO Phoenix Corporation (米国)
		SUMCO Southwest Corporation (米国)
		SUMCO Funding Corporation (米国)
STX Finance America, Inc. (米国)		
SUMCO Personnel Services Corporation (米国)		
SUMCO EUROPE SALES PLC (英国)		
PT. SUMCO Indonesia (インドネシア)		
SUMCO Singapore Pte. Ltd. (シンガポール)		
FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION (台湾)		
SUMCO Taiwan Technology CORPORATION (台湾)		

株式情報 (2016年6月末現在)

株式の情報		
発行可能株式総数	804,000,000株	
発行済株式総数	293,285,539株	
株主数	58,421名	
大株主の状況 (千株未満切捨て)		
株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
新日鐵住金株式会社	53,933	18.39%
三菱マテリアル株式会社	53,933	18.39%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	16,072	5.48%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	10,536	3.59%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,552	3.26%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	8,402	2.86%
資産管理サービス信託銀行株式会社 (投信受入担保口)	6,462	2.20%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	3,747	1.28%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	3,476	1.19%
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 620313	3,192	1.09%
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社	
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部	
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部	
電話照会先	Tel : 0120-782-031 (フリーダイヤル)	
インターネットホームページURL	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html	

株主メモ



第18期 中間期 株主通信

事業年度	毎年1月1日から12月31日まで	
定時株主総会	毎年3月開催	
基準日	定時株主総会	毎年12月31日
	期末配当金	毎年12月31日
	中間配当金	毎年 6月30日
	その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日	
単元株式数	100株	
公告の方法	電子公告とし、当社のホームページ (http://www.sumcosi.com/) に掲載いたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告いたします。	
上場取引所	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード: 3436)	

ホームページのご案内

当社は多くの株主・投資家の皆様にご利用いただけるよう、ホームページの充実を図っております。決算関係資料やニュースリリースなどのほか、当社が製造するシリコンウエーハについての情報なども掲載しております。ぜひご利用ください。

SUMCOホームページ <http://www.sumcosi.com/>

■ **株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会**
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお手続きおよびご照会は、口座のある証券会社にてお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記電話照会先までご連絡ください。

■ **単元未満株式の買取請求について**
単元 (100株) 未満株式の買取請求につきましては、株主様口座のある証券会社にお申し出ください。(証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。)

For All Innovation

シリコンウェーハは、普段生活する上では殆ど目にすることがありませんが、あらゆる電子機器に採用されているもので、実は生活に欠かすことができない製品です。

様々な技術革新が電子機器を進化させ、私たちの暮らしを豊かにし、文明を進化させます。より小さく、より大きく、より軽く、より強く、より早く。

技術者達は、過去の偉人達に挑戦し続け、乗り越え、革命を起こします。そして、その挑戦に必ず必要なのがシリコンウェーハの進化です。

社会の進展、人類の進化のためのあらゆる技術革新に貢献する企業であるために、SUMCOは、挑戦し続けます。

株式会社SUMCO

〒105-8634 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館

Tel:03-5444-0808

<http://www.sumcosi.com>

見直しに関する注意事項

本資料に記載された予測・予想・見込み・その他の将来情報および将来推定は、現時点当社が利用可能な情報および一定の前提または仮定(当社の主観的判断に基づくものを含みます。)に基づくものです。

実際の業績などは、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向、その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報および将来推定と大きく異なる可能性があります。



環境保護のために、大豆インクを使用しております。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。